

平成18年度春季全国大会シンポジウム基調講演の募集について

本会では、毎年、春季全国大会において、溶接・接合工学に関する特定の課題について、シンポジウムを開催しています。来る平成18年度春季全国大会においては、下記の主題の下、シンポジウムを開催いたします。

シンポジウムをより実りのあるものとするため、基調講演を広く募集いたします。

会員各位におかれましては、奮ってご応募下さいませよう、お願い申し上げます。

1. 主 題：「溶接構造物の長寿命化をめざして
～余寿命診断技術・延命技術・補修技術～」

2. 座 長：望月正人（大阪大学）
石川 忠（新日本製鉄㈱）

趣 旨：溶接構造物の設計・製作・運用においては、その構造物が長期間にわたって安全に、安心して使えるよう、十分な配慮をすることが重要である。特に、溶接構造物の長期使用時に損傷が顕在化するような場合への方策として、余寿命診断技術・延命技術・補修技術を適切に用いることが望まれている。

その中でも、疲労（や腐食）による損傷はこれまでの事例の中でも大きな割合を占め、その対策として種々の卓越した技術が開発されている。また、長年にわたり懸命な努力がなされてきたにも関わらず、必ずしも解決したとは言えず、今後も懸念されうる事象に対して現在も数多くの研究開発が行われているのが実情である。

このような背景を踏まえ、本シンポジウムでは、溶接構造物の長寿命化を目指して、あらためて種々の余寿命診断技術・延命技術・補修技術を取り上げ、最新

の動向を把握するとともに今後の展開について検討したい。すなわち、溶接構造物の長寿命化に対して、材料、設計、施工、検査、維持、保全、倫理、などの観点から議論を深めることによって、今後の社会における長寿命化に対する新しいコンセプトを考えていくことを目指す。

3. 日 時：平成18年4月12日（水）14：10～17：00

4. 場 所：東京ビッグサイト（東京）

5. 基調講演申し込み方法

任意の用紙にタイトル、著者、アブストラクト連絡先をご記入の上、学会事務局に提出下さい。

6. 申し込み締め切り日：平成17年8月31日（水）

7. 講演採否

申し込みいただいた講演は、採否決定次第、お知らせいたします。

8. 前刷原稿提出期日：平成17年11月30日（水）

採択された講演は、論文集第1号（2月号）に前刷りを掲載いたしますので、所定のオフセット原稿用紙6枚以内（表、図、写真を含む）の原稿を作成し、ご提出下さい。なお、講演時間は、1件20～25分程度を予定します。

9. 討論・質問の申込み

講演前刷りをご覧いただいたうえで、討論および質問を募集いたします。積極的に参加いただくことを期待します。

討論・質問の希望者は、対象講演と質問内容を簡潔に記載し、平成18年3月8日（水）までに、学会事務局あて、ご提出ください。



全国大会講演概要〈77集〉の頒布について

下記の要領により平成17年度秋季全国大会講演概要を頒布いたしますので、希望者は要領にしたがいお申込下さい。

記

1. 頒 価 5,000円
2. 申込要領 ①郵送の場合は、現品発送と同時に代金および郵便料金合計金額を請求いたしま

すので折返しご納入下さい。この場合は申込者名および送り先を明記した申込書（任意）によりFAXでお申込下さい。

②直接購入の場合は代金ご持参の上事務局までご来所下さい。また、大会当日受付でも頒布いたします。

3. 頒布開始 平成17年9月初旬予定

Mate 2006 第12回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」 シンポジウム論文募集について

主催：(社) 溶接学会 マイクロ接合研究委員会
共催：(社) 高温学会 加工・再生研究情報委員会、
(社) 機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性
設計と熱制御に関する研究分科会、(社) 日本塑性加工
学会 接合・複合分科会、エレクトロニクス生産科学
学会準備会、レーザ加工学会、大阪大学 先端科学イ
ノベーションセンター
協賛：映像情報メディア学会、エレクトロニクス実装
学会、応用物理学会、化学工学会、画像電子学会、軽
金属学会、計測自動制御学会、高温学会、高分子学会、
資源・素材学会、システム制御情報学会、情報処理学
会、人工知能学会、精密工学会、電気化学会、電気学
会、電気設備学会、電子情報通信学会、日本化学会、
日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、日本シ
ミュレーション学会、日本接着学会、日本セラミック
ス協会、日本塑性加工学会、日本顕微鏡学会日本伝熱
学会、日本非破壊検査協会、日本表面科学会、日本品
質管理学会、日本複合材料学会、日本物理学会、日本
分析化学会、日本溶接協会、表面技術協会、プラスチ
ック成形加工学会 (協賛依頼中)

日時：平成18年2月2日(木)、3日(金)
パシフィコ横浜 会議センター
5階(小ホール、501, 502)
横浜市西区みなとみらい1丁目1-1
TEL: 045-221-2121

開催主旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルな最適化とそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

参加費：主催・共催団体加入会社：20,000円
協賛学協会会員会社：30,000円
論文口頭発表者：15,000円
大学・国公立研究機関：10,000円
学生：5,000円
その他：40,000円

講演論文募集

左記主旨に従い、シンポジウムを開催いたします。つきまして、独創性に富むオリジナル講演論文を募集しております。各講演の発表時間は20分(発表12分、質問8分)、発表件数は約90件を予定しております。投稿希望の方は下記の送り先まで、応募していただくようお願い申し上げます。

なお、本シンポジウムで発表されたすべての論文発表者には、別刷り30部を無料贈呈します。また、優秀な論文に対して、シンポジウム賞(論文賞、奨励賞)の表彰制度も用意しております。

応募締切：平成17年9月1日(木) 厳守

応募方法：次の必要事項を記載して、E-mail、FAX、郵送のいずれかでMate 2006 事務局に送付して下さい。

E-mail を利用できる方はできるだけE-mailで送付していただけますようお願いいたします。

- (1) 発表題目(和文と英文)
- (2) 著者名と所属先(和文と英文)
- (3) 著者代表者の連絡先
- (4) 概要(和文120~150字程度)
- (5) トピックス記号(カテゴリー A~Cの中から該当する記号を選んで下さい)

例えば、
レーザによる微細加工プロセスに関する研究
→ A-5, B-1

携帯機器創成を目的としたソルダリング部の信頼性の研究 → A-2, B-7, C-6

申込みを受理した後1週間以内にE-mailもしくはFAXで受理通知を送付させていただきます。

受理通知が届かない場合は、Mate 2006 事務局にご確認して下さい。

また、論文採択につきましては別途、採択通知を9月末までに送付いたします。

論文原稿送付締切日：平成17年11月18日(金)

論文様式概要

本文は日本語で、Figure Captionは英語で記述する。ただし、すべて英語で記述しても結構です。

○字 体：英語の字体(フォント)はTimes、日本語の字体は明朝体とする。

○題 目：本文が日本語の場合、日本語と英語(字サイズ：14 point、題目の字体は等幅明朝体またはゴシック体とする)。

○著 者 名：本文が日本語の場合、日本語と英語(字サイズ：9 point)。

○Abstract：英語(60~120 words)(字サイズ：8 or 9 point)。

- 本文：日本語または英語
(字サイズ：9 point)，本文二段組。
 - マージン：上：25mm，下左右：20mm。
 - 用紙：A4 白用紙。
 - 図の説明：英語（図面は本文の後ろに並べてもよい）。
 - ページ数：4 ページまたは 6 ページ（奇数ページでの仕上がりは禁止する）。
- なお，論文採択決定後，詳しい投稿規定を送付します。

<論文に関する問合せ先>

大阪大学 先端科学イノベーションセンター 高橋康夫
Tel: 06-6879-4195 Fax: 06-6879-4193
E-mail: takasy@crcastr.osaka-u.ac.jp

<論文の送付先，事務に関する問合せ，連絡先>

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-11
(社) 溶接学会 Mate 2006 事務局

Mate 2006 担当連絡先
TEL: 06-6879-4166 FAX: 06-6879-4166
E-mail: mate@casi.osaka-u.ac.jp

<シンポジウム URL>

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2006.html>

トピックス記号

カテゴリーA 工 法	カテゴリーB 研究・開発の観点	カテゴリーC 対象形態・製品
A-1 マイクロ接合	B-1 プロセス	C-1 パッケージ (IC・LSI)
A-2 マイクロソルダリング	B-2 材料	C-2 モジュール
A-3 ナノプロセッシング	B-3 機能特性	(SiP・SOC, etc)
A-4 薄膜形成	B-4 メカニズム	C-3 パワーデバイス
A-5 厚膜形成 (めっきなど)	B-5 拡散現象	C-4 エネルギー変換素子
A-6 ビーム加工	B-6 界面構造	C-5 エネルギー変換機器
A-7 エッチング	B-7 信頼性	C-6 通信機器
A-8 マイクロ加工	B-8 品質	C-7 携帯機器
A-9 塑性加工	B-9 解析・シミュレーション	C-8 コンピュータ・周辺機器
A-10 接着	B-10 設計・システム	C-9 ディスプレイ
A-11 光・電子アSEMBリ	B-11 設備・機器	C-10 カーエレクトロニクス
A-12 光インターコネクション	B-12 検査・評価	C-11 医療・バイオ製品・機器
A-13 その他	B-13 生産管理・マネージメント	C-12 MEMS
	B-14 計測	C-13 航空宇宙・車両
	B-15 環境調和・リサイクル	C-14 回路・部品内蔵基板
	B-16 生産戦略・企画事業化	C-15 その他
	B-17 その他	